

连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > DIMM 插槽

DDR3 DIMM 插槽的设计符合 JEDEC 行业标准。它们有垂直和直角方向的，具有通孔和表面贴装结构。DDR3 DIMM 插槽应用包括服务器、笔记本电脑和通信设备。



DRAM 类型: 双倍数据速率 (DDR) 3

连接器系统: 板对板

位数: 240

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

模块方向: 垂直

产品特性

DDR3 内存插槽

- 为适配标准 JEDEC 内存模块而设计
- 提供低电阻垂直通孔插槽
- SO DIMM 可采用多种堆叠高度提供，可最大限度扩展电路板空间
- 提供三种板尾长度的垂直通孔插槽，可适应大多数电路板厚度

168

内存模块插针数

产品选项

- DDR3 DIMM 垂直通孔
- DDR3 DIMM 垂直表面贴装
- DDR3 DIMM 直角表面贴装
- 小型 DIMM 直角表面贴装

主要应用

DDR3 内存插槽

- 笔记本电脑
- 台式计算机
- 通信设备
- 服务器

产品特性

参考编号

| | |
|---------|------------------|
| TE 内部编号 | CAT-D3303-SO1399 |
|---------|------------------|

产品类型特性

| | |
|-----------|----------------|
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| DRAM 类型 | 双倍数据速率 (DDR) 3 |
| 连接器系统 | 板对板 |

结构特性

| | |
|------|-----|
| 行数 | 2 |
| 托架数 | 2 |
| 钥匙数 | 1 |
| 位数 | 240 |
| 模块方向 | 垂直 |

电气特征

| | |
|-------------|-----|
| DRAM 电压 (V) | 1.5 |
|-------------|-----|

主体特性

| | |
|------------|--------------------|
| 弹射器材料颜色 | 土黄色, 绿色, 黑色 |
| 模块钥匙类型 | 左偏移 |
| 弹射器位置 | 两端 |
| 插销颜色 | 土黄色, 绿色, 黑色 |
| 插销材料 | 热塑塑料, 高温尼龙, 高温热塑塑料 |
| 连接器外形 | 标准 |
| 固定柱位置 | 两端, 中心 |
| PCB 保持特性材料 | 铜合金, 黄铜 |
| 弹射器材料 | 热塑塑料, 高温尼龙, 高温热塑塑料 |
| 弹射器类型 | 旋转, 标准 |

接触件特性

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
| 端子接合区域电镀材料厚度 (μm) | .08, .38, .51, .76 |
| 端子接合区域电镀材料厚度 (μin) | 3.14, 15, 20, 30 |
| 端子基材 | 铜合金 |
| 内存插槽类型 | 内存卡 |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (μm) | 2.54, 3 |

| | |
|------------------------|------------|
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (μin) | 100, 118.1 |
| 插座种类 | DIMM |
| 端子接触部电镀材料 | 金 (Au), 镀金 |
| 端子底板材料 | 镍 |
| 端子额定电流 (最大值) (A) | .5, .75 |

端接特性

| | |
|----------------|------------------------------|
| 插入种类 | 直接插针 |
| 端接柱体和尾部长度 (mm) | 2.67, 2.85, 3.18, 3.38, 4 |
| 端接柱体和尾部长度 (in) | .105, .112, .125, .133, .157 |

PCB 端接方法 表面贴装, 通孔 - 免焊连接, 通孔 - 焊接

机械附件

| | |
|------------|--------------------|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
| 接合对准类型 | 中心, 左偏移 |
| 安装角度 | 垂直, 直角 |
| PCB 安装固定 | 带有 |
| 接合对准 | 不带, 带有 |
| PCB 安装对准类型 | 定位柱 |
| PCB 安装固定类型 | 固定卡扣/柱, 板锁, 焊尾, 焊钉 |

壳体特性

| | |
|---------------|----------------|
| 壳体颜色 | 土黄色, 蓝色, 黑色 |
| 外壳材料 | 热塑性, 高温尼龙 |
| 中心线 (间距) (mm) | 1, 2 |
| 中心线 (间距) (in) | .03, .039, .07 |

尺寸

| | |
|----------------|-----------------|
| PCB 的外形高度 (mm) | 21, 23.1 |
| PCB 的外形高度 (in) | .82, .9, .91 |
| 中心固定孔直径 (mm) | 1.8, 2.45 |
| 中心固定孔直径 (in) | .07, .096 |
| 行间距 (mm) | .95, 1.45, 1.9 |
| 行间距 (in) | .037, .05, .075 |

使用环境

| | |
|-------------|--------------------------------|
| 工组温度范围 (°C) | -55 - 105, -55 - 155, -40 - 85 |
|-------------|--------------------------------|

工作组温度范围 (°F) -67 - 311, -67 - 221, -40 - 185

操作/应用

电路应用

Signal

行业标准

UL 阻燃性等级

UL 94V-0

包装特性

封装数量

50, 54, 64, 480

封装方法

Tray, 盒和托盘, 硬托盘

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 4)



| | VERTICAL DDR3 DIMM, 240 POSITION |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| TE 产品编号 | 1932000-1 | 1-1932000-0 | 1-1932000-1 | 1-1932000-7 |
| 中心线 (间距) | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| 弹射器类型 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
| 封装方法 | Tray | Tray | Tray | Tray |
| 端子额定电流 (最大值) | .75 A | .75 A | .75 A | .75 A |
| 工组温度范围 | -55 - 155 °C |
| 欧盟 ELV 符合性 | | | | |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 尚未经过欧盟 ELV 符合性审核 | 符合欧盟 ELV 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
| 系列 | DDR3 DIMM,DDR3 SO DIMM |

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 4)



VERTICAL DDR3 DIMM, 240 POSITION VERTICAL DDR3 DIMM, 240 POSITION VERTICAL DDR3 DIMM, 240 POSITION VERTICAL DDR3 DIMM, 240 POSITION, LR

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| TE 产品编号 | 4-1932000-6 | 4-1932000-7 | 4-1932000-8 | 1932031-5 |
| 中心线 (间距) | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| 弹射器类型 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
| 封装方法 | Tray, 盒和托盘 | Tray, 盒和托盘 | Tray, 盒和托盘 | Tray, 盒和托盘 |
| 端子额定电流 (最大值) | .75 A | .75 A | .75 A | .5 A |
| 工作组温度范围 | -55 - 155 °C | -55 - 155 °C | -55 - 155 °C | -55 - 105 °C |
| 欧盟 ELV 符合性 | | | | |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合欧盟 ELV 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | 尚未经过欧盟 ELV 符合性审核 |
| 系列 | DDR3 DIMM, DDR3 SO-DIMM | DDR3 DIMM, DDR3 SO-DIMM | DDR3 DIMM, DDR3 SO-DIMM | DDR3 DIMM, Neohm LR |

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 4)



VERTICAL DDR3 DIMM, 240 POSITION, LR VERTICAL DDR3 DIMM, 240 POSITION, LR VERTICAL DDR3 DIMM, 240 POSITION, LR VERTICAL DDR3 DIMM, 240 POSITION, LR

| | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TE 产品编号 | 1-1932031-1 | 1-1932031-2 | 4-1932031-7 | 5-1932031-8 |
| 中心线 (间距) | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| 弹射器类型 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
| 封装方法 | Tray, 盒和托盘 | Tray, 盒和托盘 | Tray, 盒和托盘 | Tray, 盒和托盘 |
| 端子额定电流 (最大值) | .5 A | .5 A | .5 A | .5 A |
| 工作组温度范围 | -55 - 105 °C |
| 欧盟 ELV 符合性 | | | | |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 尚未经过欧盟 ELV 符合性审核 | 符合欧盟 ELV 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
| 系列 | DDR3 DIMM, Neohm LR |

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 4)

VLP DDR3 DIMM 240POS. 1.0
PITCH

| | |
|--------------------|------------------------|
| TE 产品编号 | 1-1932680-1 |
| 中心线 (间距) | 2 mm |
| 弹射器类型 | 旋转 |
| 封装方法 | Tray |
| 端子额定电流 (最大值) | .5 A |
| 工组温度范围 | -40 - 85 °C |
| 欧盟 ELV 符合性 | |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 超出欧盟 ELV 标准范围 |
| 系列 | DDR3 DIMM,DDR3 SO DIMM |

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

JEDEC 是其各自所有者的商标。